

# Prensa Quente A Vácuo De 200 Toneladas Com Gás Inerte

Número do item: XP29



## introdução

Prensa quente a vácuo industrial de 200 toneladas com placas aquecidas de 400x400mm, controle CLP, purga com gás inerte e vácuo profundo para laminação, colagem e cura uniformes em grandes áreas, para aplicações em pesquisa de baterias e materiais avançados. Engenharia de precisão para resultados consistentes e repetíveis.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Benefício Principal
Laminação de Polímeros de Grande Formato e FPC	Laminação sem vazios de folhas de polímero de grande área, Circuitos Impressos Flexíveis (FPC) multicamadas e painéis compósitos avançados sob vácuo contínuo.	Elimina bolhas de ar retidas e garante colagem sem defeitos, aumentando a durabilidade e o desempenho elétrico.
Colagem de Semicondutores e Wafer	Colagem termo-vácuo de perfil baixo de wafers de grande diâmetro, módulos multi-chip e substratos que exigem uniformidade precisa de temperatura e pressão.	Alcança contato interfacial uniforme e minimiza o estresse mecânico, preservando microestruturas delicadas.
Montagem de Bateria de Célula de Bolsa	Pressagem plana de precisão de eletrodos de bateria de célula de bolsa grandes e camadas de separador para otimizar o contato eletroquímico e o transporte de íons.	Aumenta a densidade de energia e a vida útil do ciclo, criando interfaces de eletrodo homogêneas.
Cura de Cerâmicas Avançadas e Compósitos	Cura assistida a vácuo e consolidação de compósitos de matriz de resina ou matriz cerâmica a temperaturas de até 250 °C.	Reduz a porosidade e aumenta a densificação, melhorando a resistência mecânica e a estabilidade térmica.
Densificação de Folha de Grafite	Alisamento e densificação de filmes de grafite flexíveis para materiais de interface térmica usados no resfriamento de eletrônicos.	Alcança alta condutividade térmica no plano e espessura uniforme para uma dissipação de calor eficaz.

Pesquisa e Desenvolvimento de Materiais	Processamento de polímeros experimentais, compósitos e revestimentos sob atmosferas controladas de vácuo/inertes para estudar relações estrutura-propriedade.	Fornecer controle ambiental preciso para investigações científicas reproduzíveis de alta fidelidade.
---	---	--

Parâmetro	Especificação	Observações
Modelo	XP29	Prensa quente a vácuo e gás inerte
Pressão Máxima de Trabalho	≤ 200 Toneladas (2.000 kN)	Gerenciada via sistema de controle CLP Siemens
Sensor de Pressão	Células de carga	Monitoramento de força real em tempo real
Dimensões da Placa	400 mm × 400 mm	Placas aquecidas duplas de grande área
Temperatura Máxima da Placa	≤ 250 °C	Controle programável por tela sensível ao toque
Potência de Aquecimento	≤ 6 kW	Elementos de aquecimento simétricos
Altura de Abertura da Placa	60 mm	Projetado para folhas, laminados e filmes finos
Bomba de Vácuo	Bomba de vácuo mecânica de palhetas rotativas	Inclusão padrão (selada a óleo)
Nível de Vácuo Final	≤ 10 Pa (aprox. 0,1 mbar)	Faixa de vácuo profundo de grosseiro a médio
Atmosfera de Trabalho	Nitrogênio (N <sub>2</sub> ) / Argônio (Ar)	Compatível com sistema de vácuo e purga
Porta de Purga	1/4" NPT	Equipado com válvula de esfera de vácuo manual

Parâmetro	Especificação	Observações
Janela de Observação	Vidro resistente a alta temperatura	Para visualização in situ da amostra
Sistema de Controle	CLP Siemens com IHM de tela sensível ao toque	Suporta programação de receitas multissegmentadas
Fonte de Alimentação	AC 220V / 50Hz (Fase Única)	Requer disjuntor dedicado de no mínimo 32A
Certificação de Segurança	Compatível com CE	Código HS: 8474802000